

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 07-275770

(43)Date of publication of application : 24.10.1995

(51)Int.Cl. B05C 5/00
B05C 5/00
B05C 11/00

(21)Application number : 06-068730

(71)Applicant : HITACHI TECHNO ENG CO LTD

(22)Date of filing : 06.04.1994

(72)Inventor : ISHIDA SHIGERU

SANKAI HARUO

YONEDA FUKUO

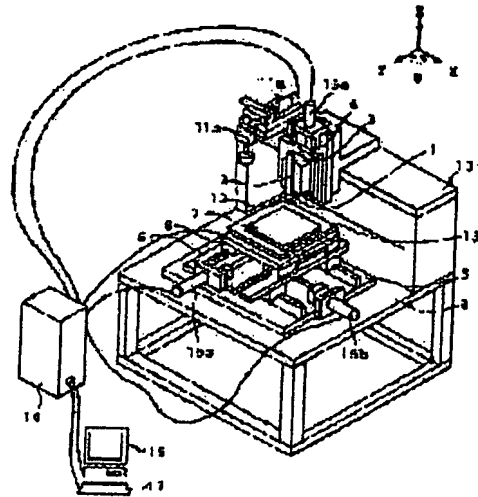
IGARASHI SHOZO

(54) PASTE APPLICATOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a paste applicator capable of easily confirming the cross section shape and cross section area of a pattern drawn on a substrate successively after the paste pattern is drawn and formed on the substrate, thereby efficiently controlling the quality and largely contributing to the improvement of productivity.

CONSTITUTION: This paste applicator is constituted so as to display the cross section shape and cross section area of the pattern on a monitor 16 by measuring the height of the surface of the substrate 7 by an optical range finder 3 after forming the paste pattern and calculating the coating height and width of the drawn pattern by using the measured data.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

24.02.1997

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than
the examiner's decision of rejection or
application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 2809588

[Date of registration] 31.07.1998

[Number of appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平7-275770

(43) 公開日 平成7年(1995)10月24日

(51) Int. Cl. ⁴	識別記号	片内整理番号	P I	技術表示箇所
B 0 5 C 5/00	Z	1 0 1		
11/00				

審査請求 未請求 請求項の数 6 O L (全 13 頁)

(21) 出願番号	特願平6-68730	(71) 出願人	000233077 日立テクノエンジニアリング株式会社 東京都千代田区神田駿河台4丁目3番地
(22) 出願日	平成6年(1994)4月6日	(72) 発明者	石田 茂 茨城県電ヶ崎市向陽台5丁目2番 日立テクノエンジニアリング株式会社開発研究所内
		(72) 発明者	三階 孝夫 茨城県電ヶ崎市向陽台5丁目2番 日立テクノエンジニアリング株式会社開発研究所内
		(74) 代理人	弁理士 武 順次郎

最終頁に続く

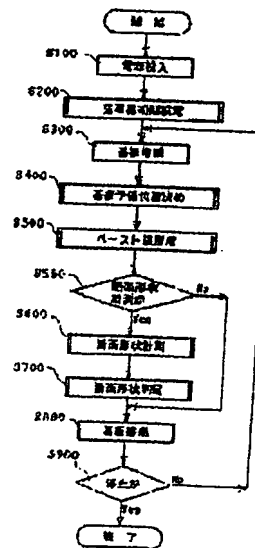
(54) 【発明の名称】 ペースト塗布機

(57) 【要約】

【目的】 基板上にペーストパターンを描画形成したなら、引き続き、該基板上の描画済みパターンの断面形状や断面積が簡単に確認できて効率的な品質管理が行え、生産性向上に寄与するところ大なるペースト塗布機を提供する。

【構成】 ペーストパターン形成後に光学式距離計により基板7の表面の高さを計測し、その計測データを用いて描画済みパターンの塗布高さおよび塗布幅を算出することにより、該パターンの断面形状や断面積がモニター16に表示されるように構成した。

(58) 【図】



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ノズルのベスト吐出口と対向するように基板をテーブル上に設置し、ベスト収納筒に充填したベストを上記吐出口から上記基板上へ吐出させながら該ノズルと該基板との相対位置関係を変化させ、該基板上に所望形状のベストパターンを描画形成するベスト塗布機において、

上記ノズルのベスト吐出口と上記基板の表面との対向間隔を計測する計測手段と、この計測手段と上記基板とを該基板の表面に沿って相対的に移動させる移動手段と、この相対的移動時における上記計測手段の計測データを用いて描画済みのベストパターンの塗布高さおよび塗布幅を算出する断面捕捉手段とを備えたことを特徴とするベスト塗布機。

【請求項2】 請求項1の記載において、上記断面捕捉手段が、計測開始と計測終了の両時点の計測データを比較演算して求めた上記基板の表面の傾き分を除去することによりデータ修正が可能な修正手段を備えていることを特徴とするベスト塗布機。

【請求項3】 請求項2の記載において、上記断面捕捉手段が、上記修正手段により修正した計測データのうちのゼロクロスする2つの計測地点間の距離から描画済みのベストパターンの塗布幅を求めるものであることを特徴とするベスト塗布機。

【請求項4】 請求項2の記載において、上記断面捕捉手段が、上記修正手段により修正した計測データを順次比較して描画済みのベストパターンの塗布高さを求めるものであることを特徴とするベスト塗布機。

【請求項5】 請求項2の記載において、上記断面捕捉手段が、上記修正手段により修正した計測データを時系列に並べて描画済みのベストパターンの断面形状に近似した輪郭を求め、かつ該輪郭をモニタに表示する輪郭表示手段を備えていることを特徴とするベスト塗布機。

【請求項6】 請求項1または2の記載において、上記断面捕捉手段が、描画済みのベストパターンの塗布幅、塗布高さ、および断面積のうち少なくともいずれかが設定許容範囲内にあるか否かを判定する異常判定手段と、この異常判定手段で許容範囲外と判定されたときに異常処理を行う異常処理手段とを備えていることを特徴とするベスト塗布機。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、テーブル上に設置された基板上にノズルからベストを吐出させながら該基板と該ノズルとを相対的に移動させることにより、該基板上に所望形状のベストパターンを塗布描画するベスト塗布機に係り、特に、描画形成したベストパターンの断面形状や断面積の管理に好適なベスト塗布機に関する。

【0002】

(2)

特開平7-275770

2

【従来の技術】 ベストが収納されたベスト収納筒の先端に固定されたノズルに、テーブル上に設置された基板を対向させ、ノズルのベスト吐出口からベストを吐出させながら該ノズルと該基板の少なくともいずれか一方を水平方向に移動させて相対位置関係を変化させることにより、基板上に所望のパターンでベストを塗布する吐出描画技術を用いたベスト塗布機の一例が、例えば特開平2-52742号公報に記載されている。

【0003】 かかるベスト塗布機は、基板として使用する絶縁基板上にノズル先端のベスト吐出口から抵抗ベストを吐出させることにより、この絶縁基板上に所望の抵抗ベストパターンを形成していくというものである。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】 ところで、上述した従来のベスト塗布機では、描画形成したベストパターンの断面形状が所望のものであるか否かについては検討されておらず、断面積のばらつきについても特に問題にはされていなかった。しかしながら、抵抗ベストパターンを描画する場合、断面積のばらつきはそのまま抵抗値のばらつきになるし、また、液晶表示装置のガラス基板にシール剤を塗布する場合、該シール剤の断面形状のばらつきはシール不足や表示欠陥等を招来する虞がある。

【0005】 それゆえ、本発明の目的は、かかる従来技術の課題を解消し、基板上に描画形成したベストパターンの断面形状や断面積が簡単に確認できて効率的な品質管理が行えるベスト塗布機を提供することにある。

【0006】

【課題を解決するための手段】 上記目的を達成するために、本発明は、ノズルのベスト吐出口と対向するように基板をテーブル上に設置し、ベスト収納筒に充填したベストを上記吐出口から上記基板上へ吐出させながら該ノズルと該基板との相対位置関係を変化させ、該基板上に所望形状のベストパターンを描画形成するベスト塗布機において、上記ノズルのベスト吐出口と上記基板の表面との対向間隔を計測する計測手段と、この計測手段と上記基板とを該基板の表面に沿って相対的に移動させる移動手段と、この相対的移動時における上記計測手段の計測データを用いて描画済みのベストパターンの塗布高さおよび塗布幅を算出する断面捕捉手段とを備える構成とした。

【0007】

【作用】 上記計測手段は、ノズルのベスト吐出口と基板表面との対向間隔を計測するというものなので、その計測データからベストパターン形成時にノズルの高さ補正などが行えるが、ベストパターン形成後に該計測手段の計測データを演算することにより、描画済みパターンの塗布高さや塗布幅を求めることができる。したがって、これら塗布高さや塗布幅を設定許容値と比較す

50

(3)

特開平7-275770

3

は、描画形成したベストパターンが許容できるものであるか否かが容易に判断できる。また、塗布高さや塗布幅がわかれば、描画済みパターンの断面形状や断面積も簡単に求められる。

【0008】

【実用例】以下、本発明の実施例を図面を用いて説明する。

【0009】図1は本発明によるベスト塗布機の一実施例を示す概略斜視図であって、1はノズル、2はベスト収納筒（またはシリンジ）、3は光学式距離計、4はZ軸テーブル、5はX軸テーブル、6はY軸テーブル、7は基板、8はθ軸テーブル、9は梁台部、10はZ軸テーブル支持部、11aは画像認識カメラ、11bはこの画像認識カメラ11aの鏡筒、12はノズル支持具、13は基板7の吸着台、14は制御装置、15a~15cはサーボモータ、16はモニター、17はキーボードである。

【0010】同図において、梁台部9上にX軸テーブル5が固定され、このX軸テーブル5上にX軸方向に移動可能にY軸テーブル6が搭載されている。そして、このY軸テーブル6上にY軸方向に移動可能かつ回転可能にθ軸テーブル8が搭載され、このθ軸テーブル8上に吸着台13が固定されている。この吸着台13上に、基板7が、例えばその各辺がX、Y各軸と平行になるように、吸着されて固定される。

【0011】吸着台13上に搭載された基板7は、制御装置14の制御駆動により、X、Y各軸方向に移動させることができる。即ち、サーボモータ15bが制御装置14によって駆動されると、Y軸テーブル6がX軸方向に移動して基板7がX軸方向へ移動し、サーボモータ15cが駆動されると、θ軸テーブル8がY軸方向に移動して基板7がY軸方向へ移動する。したがって、制御装置14によりY軸テーブル6とθ軸テーブル8とをそれぞれ任意の距離だけ移動させると、基板7は梁台部9に平行な面内で任意の方向に任意の距離だけ移動することになる。なお、θ軸テーブル8は、図4で示すサーボモータ15dにより、その中心位置を中心にθ方向に任意の角度だけ回転させることができる。

【0012】また、梁台部9上にはZ軸テーブル支持部10が設置されており、これにZ軸方向（上下方向）に移動可能にZ軸テーブル4が取り付けられている。そして、このZ軸テーブル4には、ノズル1やベスト収納筒2、光学式距離計3が設置されている。Z軸テーブル4のZ軸方向の制御駆動も制御装置14によって行なわれる。即ち、サーボモータ15aが制御装置14によって駆動されると、Z軸テーブル4がZ軸方向に移動し、これに伴ってノズル1やベスト収納筒2、光学式距離計3がZ軸方向に移動する。なお、ノズル1はベスト収納筒2の先端に設けられているが、ノズル1とベスト収納筒2の下端とは連結部を備えたノズル支持具12

10

20

30

40

50

4

を介して僅かに離れている。

【0013】光学式距離計3はノズル1の先端（下端）であるベスト吐出口と基板7の上面との間の距離を、非接触な三角測法によって測定する。

【0014】即ち、図2に示すように、光学式距離計3の下端部は三角状に切り込まれており、この切込み部分に対向する2つの斜面の一方に発光素子が、他方に受光素子がそれぞれ設けられている。ノズル支持具12はベスト収納筒2の先端に取り付けられて光学式距離計3の上記切込み部の下方まで延伸しており、その先端部の下面にノズル1が取り付けられている。光学式距離計3の上記切込み部に設けられた発光素子は、一点鏡像で示すようにベスト吐出口の真下近傍を照射し、そこからの反射光を上記受光素子が受光するようになっている。そして、ノズル1のベスト吐出口と該吐出口の下方に配置された基板7（図1参照）との間の距離が所定の範囲内である場合、発光素子からの光が発光素子に受光されるように、ノズル1と光学式距離計3との位置関係が設定されていて、ノズル1のベスト吐出口と基板7との間の距離が変化すると、該吐出口の真下近傍において、発光素子からの光の基板7上での照射点（以下、これを計測点という）の位置が変化し、よって受光素子での受光状態が変化するので、ノズル1のベスト吐出口と基板7との間の距離を計測することができる。

【0015】後述するように、基板7がX、Y軸方向に移動してベストパターンを形成しているとき、発光素子からの光の基板7上での照射点（以下、これを計測点という）が既に形成されたベストパターンを横切ると、光学式距離計3によるノズル1のベスト吐出口と基板7の表面との間の距離の計測値にベストパターンの厚み分だけの誤差が生ずる。そこで、計測点がベストパターンをできるだけ横切らないようにするため、ノズル1から基板7上へのベスト滴下点（以下、これを塗布点という）からX、Y軸に対して斜め方向にずれた位置を計測点とすると良い。

【0016】図3は光学式距離計3の計測範囲MRとノズル1の取付位置との関係を三直面で表した説明図である。同図に示すように、ノズル1の先端のベスト吐出口は光学式距離計3の計測範囲MRの中心Cと上限Uとの間に配置されており、ベストパターンPPが描画される基板7が該吐出口よりも下方で計測範囲MRの下限Lよりも上方に置かれていれば、ノズル1の真下近傍における該基板7の表面の高さ位置を、該ノズル1を基準にして、光学式距離計3により非接触に計測することができる。

【0017】なお、ベスト収納筒2中のベストが使い尽くされると、ノズル交換が行われ、塗布点が基板7上のベストを塗布しようとするある設定位置と一致するようにノズル1が取り付けられるが、ベスト収納筒2やノズル支持具12、ノズル1の取付け精度のばらつ

(4)

特開平7-275770

5

きなどにより、ノズル交換の前と後でノズル1の位置が
変わることがある。しかし、図2に示すように、塗布点
が設定位置を中心に予め設定された大きさの許容範囲
(ΔX , ΔY) 内にあるとき、ノズル1は正常に取り付
けられているものとする。但し、 ΔX は許容範囲のX軸
方向の幅、 ΔY は同じくY軸方向の幅である。

【0018】制御装置14は、光学式距離計3や画像認
識カメラ11aからデータが供給されると、これに応じ
てサーボモータ15a, 15b, 15c, や θ 軸テーブ
ル回転用のサーボモータ15d(図4参照)を駆動す
る。また、これらのサーボモータに設けたエンコーダか
ら、各モータの駆動状況についてのデータが制御装置1
4にフィードバックされる。

【0019】かかる構成において、方形をなす基板7
が吸着台13上に置かれると、吸着台13は基板7を真
空吸着して固定保持する。そして、 θ 軸テーブル8を回
転させることにより、基板7の各辺がX, Y軸それぞれ
に平行となるように設定される。しかる後、光学式距離
計3の測定結果を基にサーボモータ15aが駆動制御さ
れることにより、2軸テーブル4が下方に移動し、ノズ
ル1のベスト吐出口と基板7の表面との間の距離が規
定の距離になるまで該ノズル1を基板7の上方から下降
させる。

【0020】その後、ベスト取納筒2からノズル支持
具12を介して供給されるベストがノズル1のベスト
吐出口から基板7上へ吐出され、これとともに、サー
ボモータ15b, 15cの駆動制御によってY軸テーブ
ル8と θ 軸テーブル8が適宜移動し、これによって基板7
上に所望形状のパターンでベストが塗布される。形成
しようとするベストパターンはX, Y各軸方向の距離
で換算できるので、所望形状のパターンを形成するた
めのデータをキーボード17から入力すると、制御装置1
4は該データをサーボモータ15b, 15cに与えるパ
ルス数に変換して命令を出力し、描画が自動的に行われ
る。

【0021】図4は図1における制御装置14の一具体
例を示すブロック図であって、14aはマイクロコンピ
ュータ、14bはモータコントローラ、14caは2軸
ドライバ、14cbはX軸ドライバ、14ccはY軸ド
ライバ、14cdは θ 軸ドライバ、14dは画像処理装
置、14eは外部インターフェース、15dは θ 軸テー
ブル回転用のサーボモータ、18は光学式距離計3の測
定結果(距離)をA-D変換する変換器、Eはエンコー
ダであり、図1と対応する部分には同一符号が付してあ
る。

【0022】詳細に説明するに、制御装置14は、処理
プログラムを格納しているROMや各種データを記憶す
るRAMや各種データの演算を行うCPU等を内蔵した
マイクロコンピュータ14aと、各サーボモータ15a
~15dのモータコントローラ14bと、各サーボモ
ータ15a~15dのドライバ14ca~14cdと、画
像認識カメラ11aで読み取った画像を処理する画像処
理装置14dと、この画像処理装置14dやキーボード
17やA-D変換器18等が接続される外部インターフ
ェース14eとを備えている。キーボード17からのベ
スト描画パターンやノズル交換などを示すデータや、
光学式距離計3で計測したデータや、マイクロコンピ
ュータ14aの処理で生成された各種データなどは、マイ
クロコンピュータ14aに内蔵されたRAMに格納され
る。

【0023】次に、ベスト塗布動作と塗布描画したベ
ストパターンの形状判定に際しての制御装置14の処
理動作について説明する。なお、図5以降のフローチャ
ートにおいて、図中の符号Sはステップを意味してい
る。

【0024】図5において、電源が投入されると(ステ
ップ100)、ベスト塗布機の初期設定が実行される
(ステップ200)。この初期設定は、図6に示すよう
に、Y軸テーブル6や θ 軸テーブル8、2軸テーブル4
等を予め決められた原点位置に位置決めし(ステップ2
01)、ベストパターンのデータや基板7の位置デー
タを設定し(ステップ202)、ベストの吐出終了位
置データや形状計測データを設定する(ステップ20
3)というものであり、設定のためのデータ入力はキー
ボード17から行われる。なお、ステップ203にて行
われる形状計測データの設定とは、計測箇所数、各計
測箇所を開始位置と終了位置、各計測箇所での計測点数
(サンプリング数)などを設定することである。また、
こうしてキーボード17から入力されたデータは、前述
したように、マイクロコンピュータ14aに内蔵のRA
Mに格納される。

【0025】以上の初期設定処理が終わると、図5にお
いて、ベストパターンを描画するための基板7を吸着
台13に搭載して吸着保持させ(ステップ300)、基
板予備位置決め処理を行う(ステップ400)。

【0026】以下、図7により、このステップ400に
ついて詳細に説明する。

【0027】図7において、まず、吸着台13に搭載さ
れた基板7に予め付されている位置決め用マーク(複
数)を画像認識カメラ11aで撮影し(ステップ40
1)、画像認識カメラ11aの視野内での位置決め用マ
ークの重心位置を画像処理で求める(ステップ40
2)。そして、該視野の中心と位置決め用マークの重心
位置とのずれ量を算出し(ステップ403)、このずれ
量を用いて、基板7を所望位置に移動させるために必要
なY軸テーブル6および θ 軸テーブル8の移動量を算出
する(ステップ404)。そして、算出されたこれら移
動量をサーボモータ15b~15dの操作量に換算し
(ステップ405)、かかる操作量に応じてサーボモ
ータ15b~15dを駆動することにより、各テーブル

【0028】図7において、まず、吸着台13に搭載さ
れた基板7に予め付されている位置決め用マーク(複
数)を画像認識カメラ11aで撮影し(ステップ40
1)、画像認識カメラ11aの視野内での位置決め用マ
ークの重心位置を画像処理で求める(ステップ40
2)。そして、該視野の中心と位置決め用マークの重心
位置とのずれ量を算出し(ステップ403)、このずれ
量を用いて、基板7を所望位置に移動させるために必要
なY軸テーブル6および θ 軸テーブル8の移動量を算出
する(ステップ404)。そして、算出されたこれら移
動量をサーボモータ15b~15dの操作量に換算し
(ステップ405)、かかる操作量に応じてサーボモ
ータ15b~15dを駆動することにより、各テーブル

7

6. 8が移動して基板7が所望位置の方へ移動する(ステップ406)。

[0028]この移動とともに、再び基板7上の位置決め用マークを画像認識カメラ11aで撮影して、その視野内での位置決め用マークの中心(重心位置)を計測し(ステップ407)、視野の中心とマークの中心との偏差を求め、これを基板7の位置ずれ量としてマイクロコンピュータ14aのRAMに格納する(ステップ408)。そして、位置ずれ量が図2で説明した許容範囲の例えば1/2以下の値の範囲内にあるか否かを確認する(ステップ409)。この範囲内であれば、ステップ400の処理が終了したことになる。この範囲外にあれば、ステップ404に戻って以上の一連の処理を再び行い、基板7の位置ずれ量が上記値の範囲内に入るまで繰り返す。

[0029]これにより、基板7上のこれから塗布を開始しようとする塗布点が、ノズル1のベスト吐出口の真下より所定範囲を越えて外れることのないように、該基板7が位置決めされたことになる。

[0030]再び図5において、ステップ400の処理が終了すると、次に、ステップ500のベスト膜形成工程(処理)に移る。これを、以下、図8で説明する。

[0031]図8において、まず塗布開始位置へ基板7を移動させ(ステップ501)、次いでノズル1の高さを設定する(ステップ502)。即ち、ノズル1の吐出口から基板7の表面までの間隔が、形成するベスト膜の厚みに等しくなるように設定する。基板7は先に説明した基板予備位置決め処理(図5のステップ400)で所望位置に位置決めされているので、上記ステップ501では基板7を精度良く塗布開始位置に移動させることができ、ステップ503に移ってこの塗布開始位置からノズル1がベストの吐出を開始する。

[0032]そして、光学式距離計3によるノズル1のベスト吐出口と基板7との対向間隔の実測データを入力することにより、該基板7の表面のうわりを測定し(ステップ504)、また、この実測データにより、光学式距離計3の前述した計測点がベスト膜上を横切っているか否かの判定が行われる(ステップ505)。例えば、光学式距離計3の実測データが設定した対向間隔の許容値を外れたような場合には、計測点がベスト膜上にあると判定される。

[0033]光学式距離計3の計測点がベスト膜上にないときには、実測データを基に2軸テーブル4を移動させるための補正データを算出する(ステップ506)。そして、2軸テーブル4を用いてノズル1の高さを補正し、2軸方向でのノズル1の位置を設定値に維持する(ステップ507)。これに対し、計測点がベスト膜上を通過中と判定された場合には、ノズル1の高さを補正を行わず、この判定時の高さに保持しておく。なお、僅かな幅のベスト膜上を計測点が通過中のときに

(5)

待測平7-275770

8

は、基板7のうわりには殆ど変化がないので、ノズル1の高さを補正を行わなくともベストの吐出形状に変化はなく、所望の厚さのベストパターンを描くことができる。

[0034]次に、設定されたパターン動作が完了したかどうかを判定する(ステップ508)。完了ならばベスト吐出を終了し(ステップ509)、完了していなければベスト吐出を継続しながら基板表面のうわり測定処理(ステップ504)に戻る。したがって、計測点がベスト膜上を通過し終わると、上述したノズル1の高さを補正工程が再開される。なお、ステップ508は、それまで連続して描画していたベストパターンの終了点に達したか否かを判定する処理動作であり、この終了点は必ずしも基板7に描画しようとする所望形状全体のパターンの終了点ではない。即ち、所望形状全体のパターンは複数の互いに分かれた部分パターンからなる場合もあり、それらをすべて含む全パターンの終了点に達したか否かの判定はステップ511で行われる。なお、ステップ511に移る前にステップ510で2軸テーブル4を駆動してノズル1を退避位置まで上昇させておく。ステップ511で部分パターンは形成し終えたものの全パターンの描画は完了していないと判定されたときには、再び塗布開始位置へ基板7を移動させて(ステップ501)、以上の一連の工程を繰り返す。

[0035]このようにして、ベスト膜の形成が所望形状のパターン全体にわたって行われると、ベスト膜形成工程(ステップ500)を終了する。

[0036]再び図5において、ステップ500の処理が終了すると、ステップ550に進んで、描画形成したベスト膜の断面形状を計測するか否かを判定し、計測を行う場合は断面形状計測工程(ステップ600)に進み、行わない場合は基板排出工程(ステップ800)に進む。

[0037]以下、図9を参照しつつ、ベスト膜の断面形状計測工程(ステップ600)について説明する。

[0038]まず、ベストパターンが描かれた基板7を計測開始位置に移動させ(ステップ601)、光学式距離計3の高さを設定する(ステップ602)。そして、この計測開始位置から、光学式距離計3により基板表面(ベストパターン表面)の高さを計測し(ステップ603)、計測結果をマイクロコンピュータ14aのRAMに格納する(ステップ604)。その後、基板7を次の計測点にピッチ移動させる(ステップ605)。かかるピッチ移動の距離は形状計測区間をn等分する設定データに基づき、nの数値を多くすれば、計測点数(サンプリング数)は増える。次に、形状計測区間における高さ計測が終了したか否かを判定し(ステップ606)、終了でない場合はステップ603に戻り、新たな計測点において基板表面の高さを計測する。したがって、ステップ603からステップ606の間をn+1回

9

行き来すると、この形状計測区間での計測は終了となる。なお、光学式距離計3による計測データはピッチ毎の離散値であり、連続値ではないので、 n の数を多くすれば計測点数が増えて、計測区間内における楕円湾みパターンの断面形状の判定結果は正確になる。

【0039】形状計測区間での計測が終了したならば、光学式距離計3を上昇させ(ステップ607)、予め設定した全計測箇所について計測が完了したかどうかをステップ608で判定し、完了していないときは、計測開始位置へ基板7を移動させるステップ601に戻って、上記ステップ607までの一連の処理を繰り返す。そして、全計測箇所での計測終了ならば、この断面形状計測工程(ステップ600)は終了し、図5の断面形状判定工程(ステップ700)に移る。

【0040】以下、図10を参照しつつ、この断面形状判定工程(ステップ700)について説明する。

【0041】始めに、ステップ701で計測結果の傾き補正を行う。即ち、図1の架台部9は本来、吸着台13が水平となるように設置されているはずなので、基板表面の高さを計測した光学式距離計3の計測結果は、図11の(a)で示すように、ペースト膜不在領域において基板表面の高さ位置が零レベルを維持するはずであるが、実際には架台部9の傾きなどにより、図11(b)、(c)に示すように計測結果が右上がりもしくは左下がりとなる場合がある。そこで、形状計測区間MAにおける計測開始位置の計測データDsと計測終了位置の計測データDeの差から、計測結果の補正に必要な基板表面の傾きを求め、この傾きに起因する計測データの誤差を排除すべく、ステップ701で傾き補正を行う。なお、図11では便宜上、計測データを連続値で示しているが、前述したように計測データは離散値である。

【0042】次に、傾きを補正した計測データからゼロクロス位置P1、P2を得て、これらゼロクロス位置P1、P2の間隔をペーストパターンの塗布幅とする(ステップ702)。その後、傾きを補正した計測データ(各離散値)を、計測開始位置の計測データDsから計測終了位置の計測データDeの間で順次比較して最大値を求め、その値をペーストパターンの塗布高さDhとする(ステップ703)。

【0043】次に、ステップ704に進んで、ステップ702および703の処理で求めたペーストパターンの塗布幅(P2-P1)および塗布高さDhを、予め設定してあった基準値データと比較し、基準値以内であるか否かを判定する。もしも基準値を外れている場合には、ステップ705に進み、図1のモニタ16に異常内容を表示するなどの異常処理を行う。そして、基準値内の場合および異常処理が終了した場合には、ステップ706に進んで全計測箇所の断面形状判定処理が完了したか否かを判定し、完了でない場合はステップ701に戻って

(6)

待開平7-275770

10

上述した一連の処理を繰り返し行い、完了した場合には全計測箇所の形状判定結果を表示し(ステップ707)、断面形状判定工程(ステップ700)を終了する。

【0044】再び図5において、上述したステップ700が終了すると、ステップ800に移って基板排出処理が行われ、基板7が吸着台13から外される。しかる後、以上の全工程を停止するか否かを判定し(ステップ900)、別の基板と同じパターンでペーストを塗布箇所する場合にはステップ300に戻って、該基板に対しステップ300~900の一連の処理を繰り返す。

【0045】このように、上記実施例では、ペースト膜形成工程(ステップ500)でノズル1の高さ補正に必要なデータを計測する光学式距離計3を用いて、ペースト膜形成後に、楕円湾みパターン形成したペースト膜の断面形状が判定できる(ステップ600および700)ようになっているので、効率の良い品質管理が行える。

【0046】例えば、液晶表示装置を製造する場合、楕円湾みパターン形成したシール剤が図12(a)に示すような所望の幅および高さを備えた階梯形のペーストパターンPPになっていれば、ガラス基板どうしを貼り合せたときに充分なシール効果を期待できるが、図12(b)、(c)に示すようにペーストパターンPPの塗布幅と塗布高さのいずれかが所望の値でないと、充分なシール効果を期待できない。即ち、図12(b)に示すように塗布幅が不所望に小さくなると、パターン切れを引き起こしてシール不良が発生しやすくなり、ペーストパターンPPが抵抗ペーストの場合には高抵抗化や断線の原因となる。また、図12(c)に示すように中央部に凹みが生じて塗布高さが不足していると、2枚のガラス基板を貼り合せたときに該凹み部分が両ガラス基板の間に閉じ込められてボイドとなり、シール効果を低下させてしまう。さらに、図示はしていないがペーストパターンの幅や高さが所望値よりも大きいと、抵抗ペーストでは低抵抗化や短絡を招来し、液晶表示装置のシール剤の場合は2枚のガラス基板を貼り合せたときに余分なシール剤が溢れ出し、ガラス基板上に設けられているTFTを該シール剤が覆ってしまうなどの表示欠陥を招来しやすくなる。

【0047】したがって、楕円湾みパターンの塗布幅や塗布高さが許容値から外れているときに、その断面形状をモニタ16に表示して確認できるようにしておく、製作される製品の仕上がり状態が推定でき、製作工程の途中で良品と不良品とを仕分けすることができるので、効率的な品質管理が行え、生産性向上に大きく寄与できる。しかも、ペーストパターンを塗布箇所した基板を装置から取り外したり該装置の部品交換を行ったりせずに、そのまま楕円湾みパターンの断面形状判定工程へ移ることができるので、判定のための煩雑な準備作業が不要で、生産ラインを複雑化させる心配もない。

【0048】なお、ペーストパターンの塗布高さが0に

なっていた場合はパターン切れを意味するが、パターン切れの原因としてペースト収納筒2内のペーストが消費されてしまった可能性もあるので、異常な塗布高さをモニタ16に表示して確認すればペースト収納筒2内のペースト残量チェックも行える。

【0049】最後に、図13を参照しつつ、描画済みパターンの断面形状表示のために行われるマイクロコンピュータ14a(図4参照)の演算処理について説明する。

【0050】図13において、黒点で示すMPxは、形状計測区間をn等分した各ピッチにおける計測点。またHxは、各計測点MPxにおいて得られた描画済みパターンの塗布高さの計測データであり、各計測データHxはマイクロコンピュータ14aのRAMに格納されている。それゆえ、各計測データHxを順次(時系列に)モニタ16に表示していくことにより、描画済みパターンの断面形状の輪郭を表示することができる。

【0051】また、断面形状の表示に加えて断面積を表示する場合には、次のような処理を行う。即ち、形状計測区間をn等分した各ピッチの間隔をWxとすると、各ピッチ間隔Wxの範囲内で描画済みパターンの塗布高さを同等とみなす近時が行えるので、形状計測区間の全部について、マイクロコンピュータ14aのRAMに格納されている各計測データHxとピッチ間隔Wxとの積を合算し、Σ(Wx×Hx)の値を求めれば、図13に破線で示す描画済みパターンの実際の断面形状の面積に近似した断面積が得られ、等分数nを大きく設定することにより近似度を高めることができる。

【0052】こうして描画済みパターンの断面積が把握できるようにしておく。特に抵抗用ペーストを描画する場合、所望の抵抗値になっているかどうかを確認するうえで有効である。つまり、抵抗用ペーストの場合には、パターンの幅や高さが所望値から外れていても、断面積が許容値内であれば所望の抵抗値が得られるので、前述した断面形状判定工程(ステップ700)において、塗布幅や塗布高さが基準値内か否かを判定する代わりに、断面積が基準値内か否かを判定するようにしても良い。

【0053】なお、塗布機初期設定処理(ステップ200)での所要時間の短縮化を図るため、外部インターフェース14e(図4参照)に、ICカードあるいはフロッピディスクやハードディスクなどの外部記憶手段が接続される記憶読み出し装置を接続し、一方、パーソナルコンピュータなどで塗布機初期設定処理に必要なデータ設定を前もって実行しておき、塗布機初期設定処理時に、外部インターフェース14eに接続した記憶読み出し装置を介して外部記憶手段から各種データをマイクロコンピュータ14aのRAMに移すようにしても良い。また、計測したデータをICカードあるいはフロッピディスクやハードディスクなどの外部記憶手段に格納し

て、マイクロコンピュータ14aのRAMの記憶容量拡大を図ったり、判定結果についてのデータを外部記憶手段に格納して後日利用できるようにしても良い。

【0054】

【発明の効果】以上説明したように、本発明によるペースト塗布機は、ノズルのペースト吐出口と基板表面との対向間隔を計測する計測手段のデータを用いて、該基板上に描画形成したペーストパターンの塗布高さおよび塗布幅を算出することにより、描画済みパターンが所望の断面形状や断面積になっているか否かが簡単に判定できるので、効率的な品質管理が行え、しかも判定のための煩雑な準備作業が不要なので、生産性向上に寄与するところ極めて大である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明によるペースト塗布機の一実施例を示す概略斜視図である。

【図2】同実施例のノズルと光学式距離計との配置関係を示す斜視図である。

【図3】同実施例のノズルの取付位置と光学式距離計の計測原理との関係を正面で表した斜視図である。

【図4】同実施例の制御装置の一具体例を示すブロック図である。

【図5】同実施例の全体動作を示すフローチャートである。

【図6】図5におけるペースト塗布機の初期設定工程を示すフローチャートである。

【図7】図5における基板予備位決め工程を示すフローチャートである。

【図8】図5におけるペースト膜形成工程を示すフローチャートである。

【図9】図5におけるペースト膜の断面形状計測工程を示すフローチャートである。

【図10】図5におけるペースト膜の断面形状判定工程を示すフローチャートである。

【図11】同実施例で描画済みパターンの塗布高さおよび塗布幅を算出するデータ処理について説明するための図である。

【図12】描画されたペーストパターンの断面形状が所望の場合や不所望の場合の具体例を示す図である。

【図13】同実施例で描画済みパターンの断面形状や断面積を判定するデータ処理について説明するための図である。

【符号の説明】

- 1 ノズル
- 2 ペースト収納筒
- 3 光学式距離計
- 4 Z軸テーブル
- 5 X軸テーブル
- 6 Y軸テーブル
- 7 基板

(8)

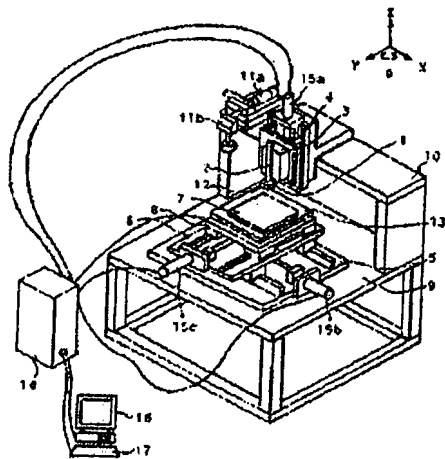
特開平7-275770

- 8 θ軸テーブル
- 9 基台部
- 10 2軸テーブル支持部
- 11a 画像認識カメラ
- 12 ノズル支持具

- * 13 吸着台
- 14 制御装置
- 15a~15d サーボモータ
- 16 モニタ
- * 17 キーボード

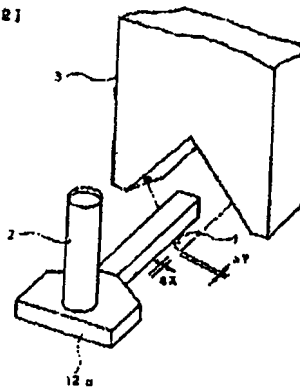
【図1】

【図1】



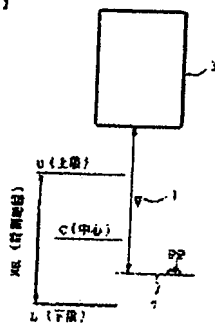
【図2】

【図2】



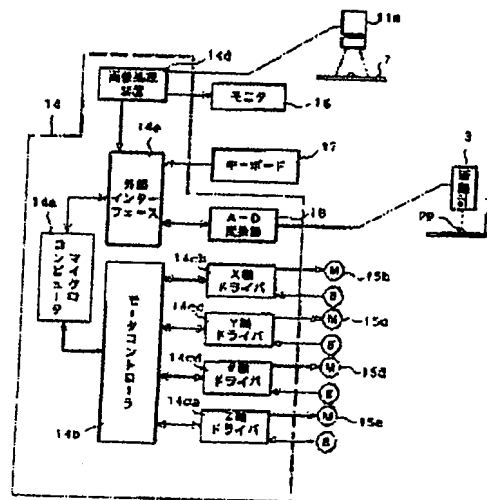
【図3】

【図3】



【図4】

【図4】

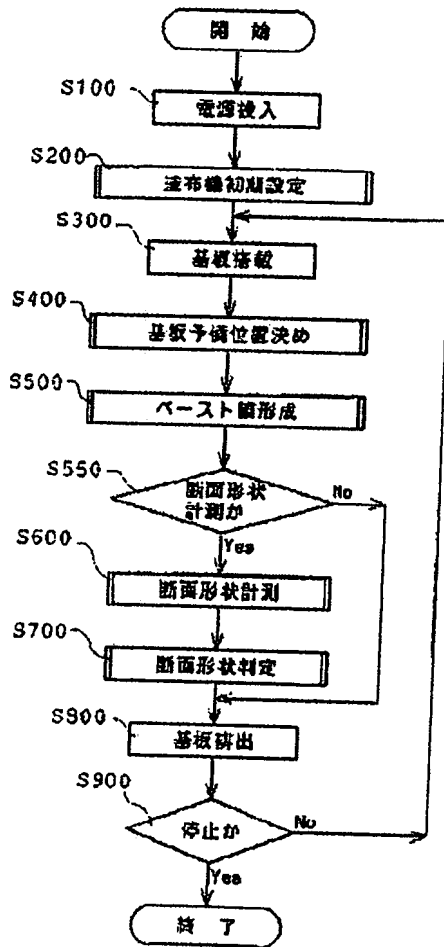


(9)

特開平7-275770

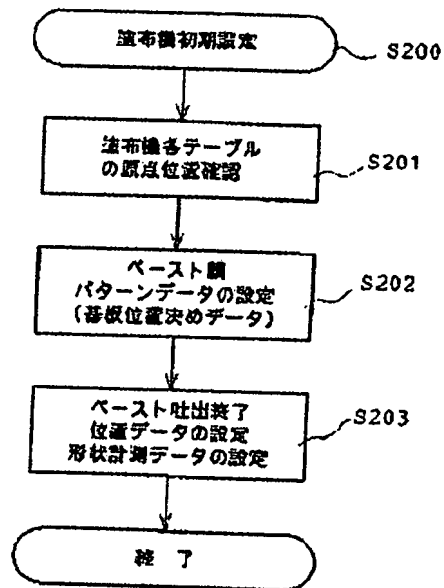
【図5】

【図6】



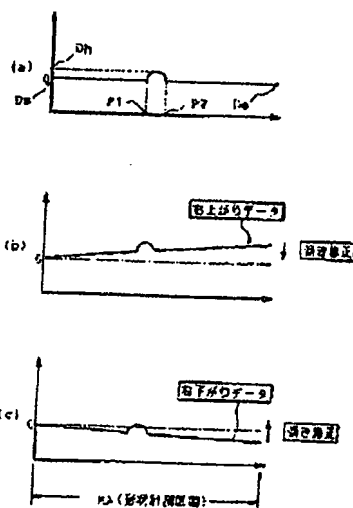
【図6】

【図6】



【図11】

【図11】



【図13】

【図13】

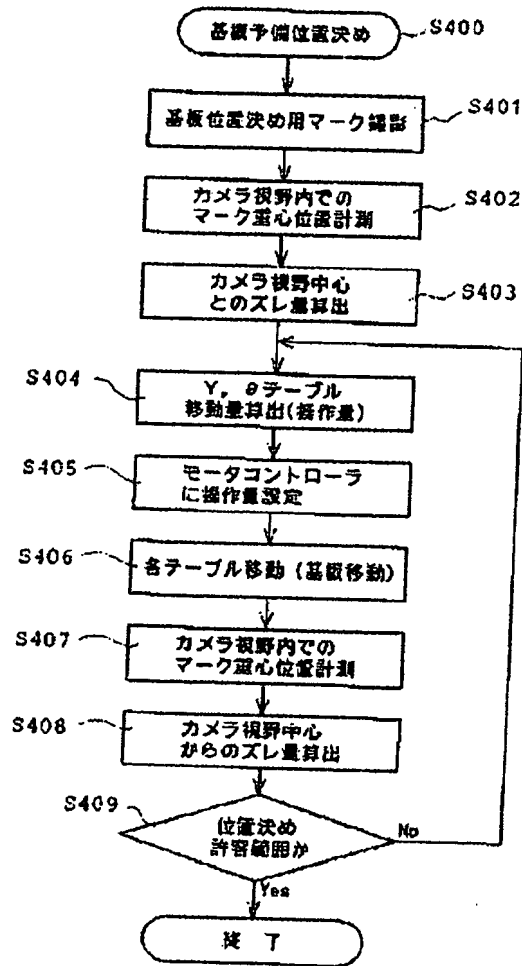


(10)

特開平7-275770

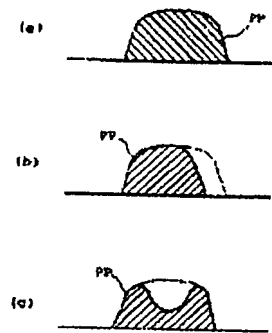
【図7】

【図7】



【図12】

【図12】

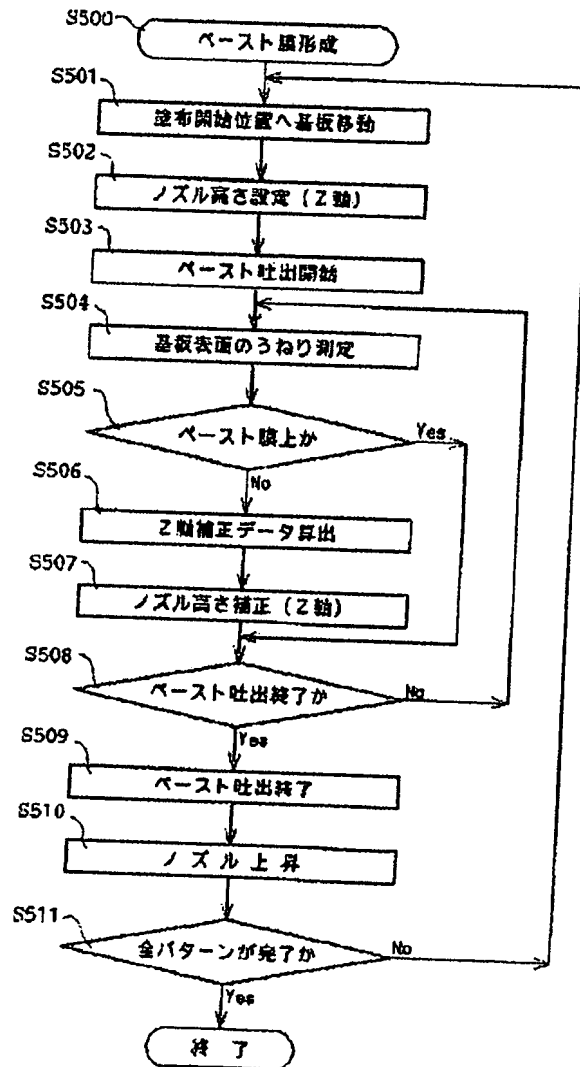


(11)

特開平7-275770

【図8】

【図8】

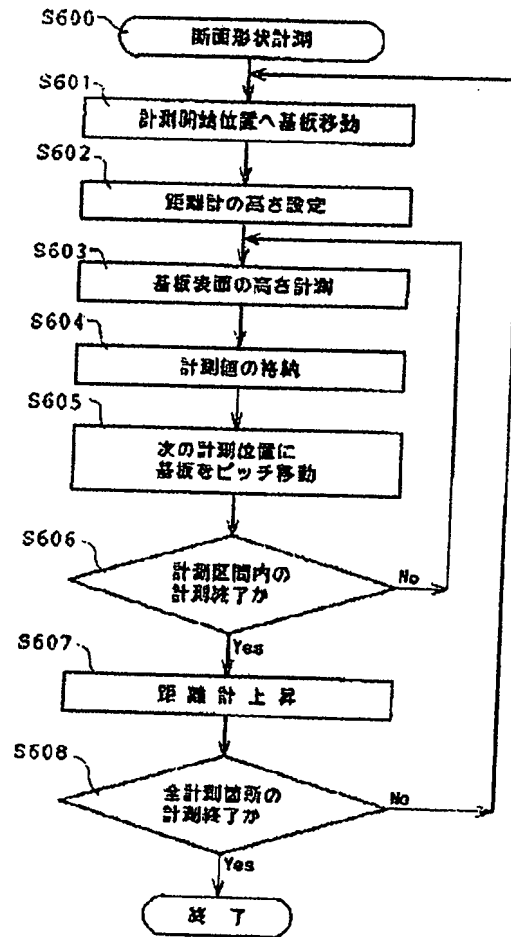


(12)

特開平7-276770

【図9】

【図9】

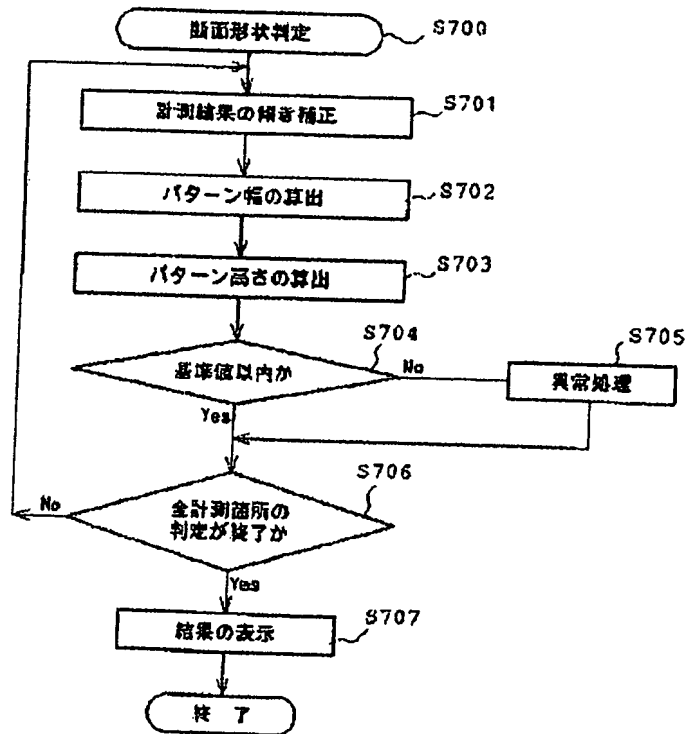


(13)

特開平7-275770

【図10】

【図10】



フロントページの続き

(72)発明者 木田 福男

茨城県竜ヶ崎市向陽台5丁目2番 日立テ
クノエンジニアリング株式会社開発研究所
内

(72)発明者 五十嵐 省三

茨城県竜ヶ崎市向陽台5丁目2番 日立テ
クノエンジニアリング株式会社竜ヶ崎工場
内

特開平7-275770

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第1区分

【発行日】平成10年(1998)9月22日

【公開番号】特開平7-275770

【公開日】平成7年(1995)10月24日

【年号号数】公開特許公報7-2758

【出願番号】特願平6-68730

【国際特許分類第6版】

B05C 5/00

101

11/00

【F1】

B05C 5/00

2

101

11/00

【手続補正書】

【提出日】平成9年2月24日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0020

【補正方法】変更

【補正内容】

【0020】その後、ペースト収納筒2からノズル支持具12を介して供給されるペーストがノズル1のペースト吐出口から基板7上へ吐出され、これとともに、サーボモータ15b、15cの駆動制御によってY軸テーブル6とθ軸テーブル8が適宜移動し、これによって基板7上に所望形状のパターンでペーストが塗布される。形成しようとするペーストパターンはX、Y各軸方向の距離で換算できるので、所望形状のパターンを形成するためのデータをキーボード17から入力すると、制御装置14は該データをサーボモータ15b、15cに与えるパルス数に変換して命令を出力し、描画が自動的に行われる。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0044

【補正方法】変更

【補正内容】

【0044】再び図5において、上述したステップ700が終了すると、ステップ800に移って基板排出処理が行われ、基板7が吸着台13から外される。しかる後、以上の全工程を併止するか否かを判定し(ステップ900)、別の基板に同じパターンでペーストを塗布描画する場合にはステップ300に戻って、該基板に対しステップ300～900の一連の処理を繰り返す。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0051

【補正方法】変更

【補正内容】

【0051】また、断面形状の表示に加えて断面積を表示する場合には、次のような処理を行う。即ち、形状計測区間を n 等分した各ピッチの間隔を W_x とすると、各ピッチ間隔 W_x の範囲内で描画済みパターンの塗布高さを同等とみなす近似が行えるので、形状計測区間の全部について、マイクロコンピュータ14aのRAMに格納されている各計測データ H_x とピッチ間隔 W_x との積を合算し、 $\Sigma(W_x \times H_x)$ の値を求めれば、図13に破線で示す描画済みパターンの実際の断面形状の面積に近似した断面積が得られ、等分数 n を大きく設定することにより近似度を高めることができる。

【手続補正4】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図2

【補正方法】変更

【補正内容】

【図2】

特開平 7-275770

